

2026-2031年中国晶圆代工行业全景调研及发展趋势预测研究报告

报告简介

晶圆代工行业是半导体产业链的核心制造环节，采用Foundry专业化代工模式，不开展芯片自主设计业务，承接无晶圆芯片设计企业的流片委托，通过光刻、刻蚀、薄膜沉积等上百道精密工艺，将芯片设计版图转化为实体硅基晶圆产品。行业覆盖先进逻辑工艺、成熟逻辑工艺以及功率半导体、模拟芯片等特色工艺，产出的晶圆产品经过封测后，应用于算力硬件、汽车电子、工业控制、消费电子等各类终端领域。完整产业链上游涵盖半导体设备、硅片、电子化学品、光罩等关键物料，中游为晶圆代工生产制造，下游对接芯片设计公司与封测厂商，兼具资本密集、技术密集、人才密集的显著特征，晶圆代工的工艺能力、产能供给直接决定国内集成电路产业链的整体安全水平。

当前中国晶圆代工行业处于成熟工艺规模化发展、先进工艺持续攻坚的发展阶段，国内已经形成龙头企业引领、多梯队厂商协同发展的产业格局，市场主体兼顾先进逻辑工艺、8英寸与12英寸成熟产线、特色工艺制造等不同发展方向，各家企业在工艺积累、良率管控、产线运营、客户服务体系层面分化明显。下游汽车半导体、工业芯片、物联网芯片带动成熟制程订单保持旺盛，同时高端算力芯片也对先进工艺提出更高要求，但行业发展依旧面临核心设备材料配套约束、先进工艺研发难度大、产线资本投入规模庞大等现实挑战。产业发展不再单纯追求产能规模扩张，工艺稳定性、良率水平、全流程交付能力成为企业市场竞争的核心重点，产业链本土化配套协同的重要性持续凸显。未来，国内晶圆代工行业发展重心将从产能扩建，转向特色工艺深耕、先进工艺持续迭代、产业链上下游协同配套等高价值方向演进。国内芯片设计产业持续壮大，国产替代稳步推进，汽车电子、功率器件、AI相关芯片的需求持续释放，为本土代工产业带来广阔的市场空间。行业将兼顾先进制程攻关与成熟特色工艺提质升级两条发展主线，对企业的工艺研发能力、供应链风险管控、产线精细化运营能力提出更高要求，工艺与先进封装的协同发展也将为产业发展开辟新的实现路径。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及晶圆代工行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国晶圆代工行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外晶圆代工行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了晶圆代工行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于晶圆代工产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国晶圆代工行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 晶圆代工行业基础概述

第一节 行业基本界定

一、行业概念与业务模式

二、行业主要分类维度

三、行业生产流程说明

第二节 行业研究边界与统计口径

一、统计范围界定

二、数据来源说明

三、指标核算方法

第三节 行业核心壁垒分析

一、技术工艺壁垒

二、资本投入壁垒

三、客户认证壁垒

第二章 晶圆代工行业产业链完整解析

第一节 产业链整体架构

一、上游环节构成

二、中游制造环节

三、下游应用环节

第二节 上游产业链深度拆解

一、硅片供给环节分析

二、半导体设备供给环节分析

三、配套化工材料供给环节分析

第三节 下游需求产业链拆解

一、下游需求传导逻辑

二、下游行业景气度关联

三、产业链价值分配特征

第三章 全球晶圆代工行业发展现状与供需格局

第一节 全球晶圆代工行业发展概况

一、全球行业发展演进阶段

二、全球产能整体供给现状

三、全球行业周期运行特征

第二节 全球晶圆代工市场规模数据分析

一、全球营收规模及变化

二、全球晶圆出货量统计

三、全球产能利用率变化

第三节 全球晶圆代工供需结构分析

一、供给端产能分布格局

二、需求端市场结构特征

三、供需错配与缺口分析

第四章 2024-2026年中国晶圆代工行业市场规模分析

第一节 中国晶圆代工行业供给现状

一、国内整体产能规模

二、不同尺寸晶圆产能分布

三、产能利用率运行情况

第二节 国内市场营收规模测算

一、行业整体营收规模

二、按工艺节点营收结构

三、按晶圆尺寸营收结构

第三节 国内市场需求规模分析

一、国内整体芯片代工需求

二、需求结构拆分分析

三、自给率现状数据分析

第五章 晶圆代工细分工艺市场分析

第一节 先进制程代工市场

一、先进制程产能供给现状

二、先进制程市场需求特征

三、先进制程市场规模变化

第二节 成熟制程代工市场

一、成熟制程产能供给现状

二、成熟制程市场需求特征

三、成熟制程市场规模变化

第三节 特色工艺代工市场

一、特色工艺产能供给现状

二、特色工艺市场需求特征

三、特色工艺市场规模变化

第六章 晶圆代工下游细分应用市场分析

第一节 算力芯片代工需求市场

一、算力芯片代工需求现状

二、算力芯片代工规模统计

三、算力芯片代工需求特点

第二节 消费电子芯片代工市场

一、消费电子代工需求现状

二、消费电子代工规模统计

三、消费电子代工需求特点

第三节 汽车电子芯片代工市场

一、汽车电子代工需求现状

二、汽车电子代工规模统计

三、汽车电子代工需求特点

第四节 工业及其他芯片代工市场

一、工业领域代工需求现状

二、工业领域代工规模统计

三、工业领域代工需求特点

第七章 中国晶圆代工区域市场格局分析

第一节 华东地区晶圆代工市场

一、区域产能布局现状

二、区域市场规模数据

三、区域产业发展特征

第二节 华南地区晶圆代工市场

一、区域产能布局现状

二、区域市场规模数据

三、区域产业发展特征

第三节 华中地区晶圆代工市场

一、区域产能布局现状

二、区域市场规模数据

三、区域产业发展特征

第四节 华北地区晶圆代工市场

一、区域产能布局现状

二、区域市场规模数据

三、区域产业发展特征

第五节 西部地区晶圆代工市场

一、区域产能布局现状

二、区域市场规模数据

三、区域产业发展特征

第八章 晶圆代工行业技术迭代演进分析

第一节 逻辑工艺技术演进

一、先进逻辑工艺迭代路径

二、成熟逻辑工艺优化方向

三、逻辑工艺技术瓶颈分析

第二节 特色工艺技术发展

一、功率器件工艺发展情况

二、模拟bcd工艺发展情况

三、传感器类工艺发展情况

第三节 配套协同技术发展

一、chiplet协同制造技术

二、先进封装配套制造要求

三、新材料适配制造技术

第九章 晶圆代工行业供给端产能建设分析

第一节 国内晶圆厂在建产能梳理

一、12英寸晶圆在建产线情况

二、8英寸晶圆在建产线情况

三、扩产项目建设周期特征

第二节 产能建设资本开支分析

一、行业整体资本开支规模

二、不同产线资本开支差异

三、资本开支周期波动特征

第三节 产能释放节奏研判

一、产线建设到量产周期

二、良率爬坡周期规律

三、2026-2031年产能释放节奏

第十章 晶圆代工行业竞争格局分析

第一节 全球晶圆代工竞争格局

一、全球市场份额分布

二、全球企业梯队划分

三、全球竞争格局演变特征

第二节 中国本土晶圆代工竞争格局

一、国内市场份额分布

二、本土企业梯队划分

三、本土竞争格局演变特征

第三节 行业竞争关键要素分析

一、工艺技术竞争维度

二、产能规模竞争维度

三、成本交付竞争维度

第十一章 国内十家重点晶圆代工企业深度分析

第一节 中芯国际集成电路制造有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第二节 华虹半导体有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第三节 合肥晶合集成电路股份有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第四节 华润微电子有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第五节 上海积塔半导体有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第六节 粤芯半导体技术股份有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第七节 芯联集成股份有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第八节 武汉新芯集成电路制造有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第九节 上海华力微电子有限公司

一、企业概况

二、产品与经营分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业发展动态

第十节 江苏中科芯集成电路制造有限公司

- 一、企业概况
- 二、产品与经营分析
- 三、竞争优势与市场地位
- 四、企业发展动态

第十二章 晶圆代工行业投融资与并购重组分析

第一节 行业投融资整体概况

- 一、投融资规模统计
- 二、投融资轮次结构
- 三、投融资赛道分布

第二节 行业并购重组案例分析

- 一、横向产能整合并购
- 二、产业链纵向并购
- 三、并购交易核心特征

第三节 行业资本退出路径分析

- 一、ipo上市退出路径
- 二、股权转让退出路径
- 三、行业资本趋势判断

第十三章 晶圆代工行业成本与盈利水平分析

第一节 行业成本结构拆解

- 一、固定资产折旧成本
- 二、原材料采购成本

三、人力及制造运营成本

第二节 行业盈利指标数据分析

一、行业毛利率变化情况

二、行业净利率变化情况

三、不同工艺盈利水平差异

第三节 影响盈利水平核心因素

一、产能利用率影响

二、产品结构影响

三、规模效应影响

第十四章 2026-2031年中国晶圆代工行业市场预测

第一节 供给端产能预测

一、整体产能规模预测

二、分尺寸产能结构预测

三、分工艺节点产能预测

第二节 需求端市场规模预测

一、行业整体营收规模预测

二、下游分领域需求预测

三、市场自给率变化预测

第三节 行业供需平衡预测

一、整体供需缺口测算

二、先进制程供需预判

三、成熟制程供需预判

第十五章 2026-2031年行业发展趋势预判

第一节 工艺技术发展趋势

- 一、先进工艺迭代趋势
- 二、成熟特色工艺升级趋势
- 三、制造与封装协同发展趋势

第二节 供给产能发展趋势

- 一、产能扩张结构趋势
- 二、产线建设模式变化
- 三、区域产能布局趋势

第三节 市场竞争格局趋势

- 一、本土企业份额变化趋势
- 二、差异化竞争发展趋势
- 三、全球供应链格局演变趋势

第十六章 行业面临的风险因素分析

第一节 技术迭代风险

- 一、工艺研发不及预期风险
- 二、技术路线迭代风险
- 三、良率爬坡不及预期风险

第二节 市场周期波动风险

- 一、下游终端需求波动风险
- 二、产能过剩价格竞争风险
- 三、库存周期波动风险

第三节 供应链配套风险

- 一、上游关键物料供给风险
- 二、设备交付周期风险
- 三、供应链配套进度风险

第十七章 行业发展机遇与投资策略建议

第一节 行业发展机遇识别

- 一、下游新兴应用带来增量机遇
- 二、本土市场需求释放机遇
- 三、特色工艺赛道成长机遇

第二节 行业投资机会研判

- 一、产能建设方向机会
- 二、细分工艺赛道机会
- 三、产业链配套协同机会

第三节 产业经营策略建议

- 一、企业技术布局策略
- 二、产能规划建设策略
- 三、市场客户拓展策略

图表目录

图表：晶圆代工完整产业链架构

图表：2024-2026年全球晶圆代工市场营收规模变化

图表：2024-2026年中国晶圆代工行业营收规模变化

图表：2026年中国晶圆代工按工艺节点营收占比结构

图表：中国晶圆代工按晶圆尺寸产能分布占比

图表：国内各区域晶圆代工产能分布对比

图表：全球晶圆代工市场份额占比

图表：2026年中国本土晶圆代工市场份额占比

图表：2026-2031年中国晶圆代工市场营收规模预测趋势

图表：2026-2031年中国晶圆代工分工艺产能预测趋势

图表：晶圆代工行业主要业务模式对比

图表：2023-2025年全球晶圆代工产能、出货量及产能利用率统计

图表：2023-2025年中国晶圆代工市场核心指标统计

图表：国内主要晶圆代工企业核心产能、工艺节点汇总

图表：2026-2031年中国晶圆代工市场规模预测数据

图表：2026-2031年国内分工艺节点产能预测数据

图表：行业成本结构占比统计简

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4069439

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260828/4069439.shtml>

在线订购：[点击这里](#)